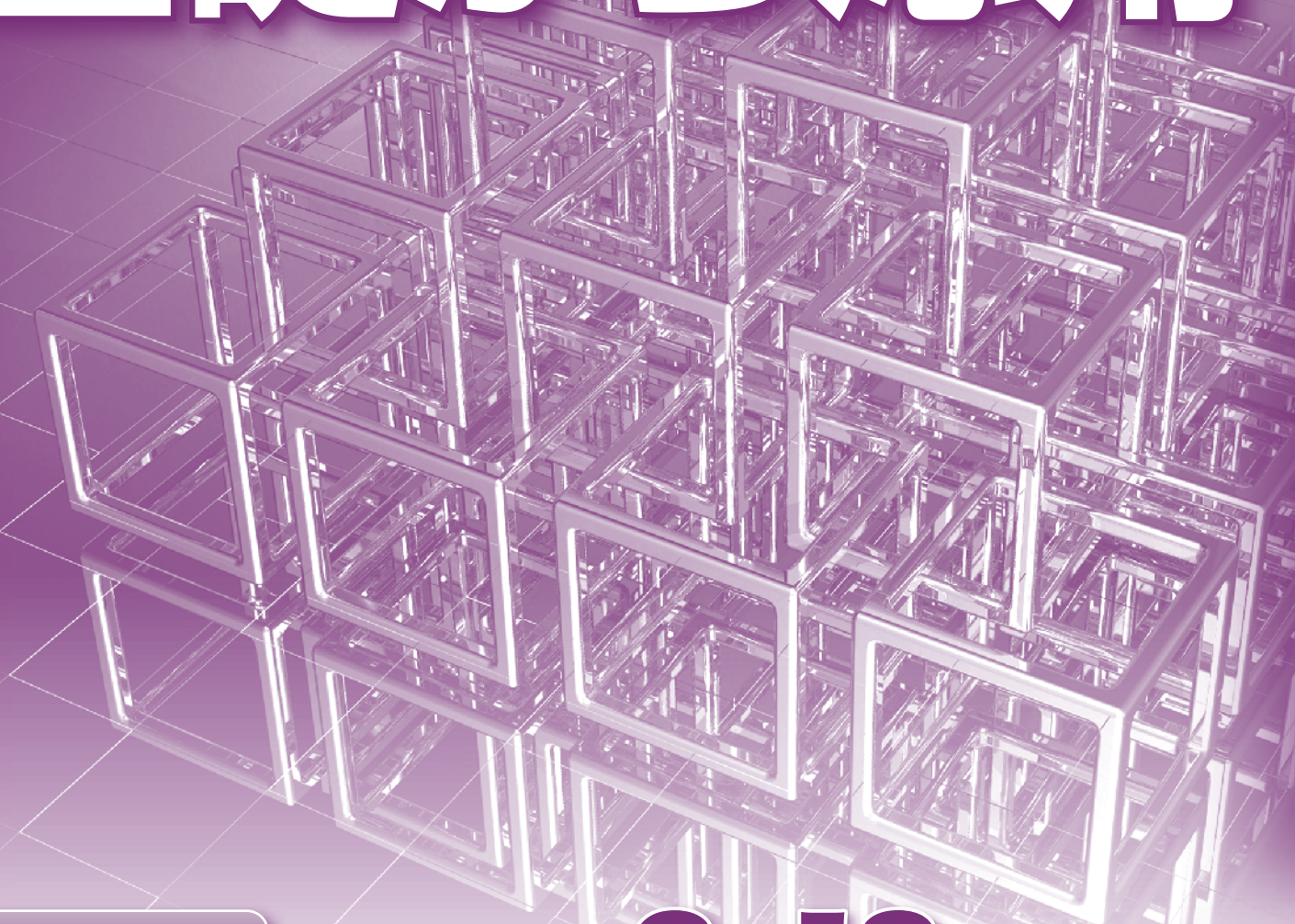
第46回 応用物理学会スクール（2010年春季）

〈集積化MEMS技術研究会〉

集積化MEMS技術 基礎から応用



近年MEMSの市場は、加速度センサ、圧力センサ、ディスプレイデバイスなどの実用化を例に、予想以上の確実な伸びを示しています。集積化MEMSデバイスは、半導体産業の次のビジネスキーデバイスと考えられています。現状、集積化MEMS技術として、MEMSの集積化、CMOSLSIとの集積化などさまざまな提案がされています。特に、世界的潮流として、MEMS技術とLSI技術との融合は、重要な課題でありMore than Mooreの一つの解として期待され研究開発が活発化しています。

一方で、MEMS技術と「集積化」については、材料、プロセス、デバイス構造、統合設計技術、CMOSとMEMSとの融合技術、実装技術、高歩留り技術、高信頼化技術等多くの研究課題が顕在化してきています。

このスクールでは、集積化MEMS技術の基礎から応用について、原理、課題、最近の話題まで分かりやすくご紹介していただきます。

期　日　2010年3月18日(木) 春季講演会2日目

会　場　東海大学 総合体育館特設会場（ZV会場） 神奈川県平塚市北金目1117

テキスト	当日会場にて配布いたします。 （1冊1000円、ご希望者のみ）
申込締切	2010年3月10日（水）
申込方法	http://www.jsap.or.jp/ 定員に余裕がある場合は当日会場にて受付いたします。
参加定員	200名

プログラム

①9:25–9:30	ごあいさつ （教育・公益事業委員会委員長）渡辺 美代子（東芝）
②9:30–9:40	イントロダクトリトーク 益 一哉（東工大）
③9:40–10:10	[基調講演] 集積化MEMS技術 石田 誠（豊橋技科大学）
④10:10–10:50	MEMSデバイスとプロセス技術 田中 秀治（東北大学）
⑤10:50–11:30	MEMSの統合設計技術 年吉 洋（東京大学）
⑥11:30–12:10	MEMSデバイスの材料技術 秦 誠一（東工大）
12:10–13:00	昼 食
⑦13:00–13:40	集積化センサとその応用 前中 一介（兵庫県立大）
⑧13:40–14:20	MEMSデバイスの実装におけるパッケージング技術の課題と動向 千野 満（ミスズ工業）
⑨14:20–15:00	集積化MEMS技術の無線通信デバイスへの応用 桑原 啓（NTT）
15:00–15:20	休 憩
⑩15:20–16:00	エネルギーハーベストとMEMS 鈴木 雄二（東京大学）
⑪16:00–16:40	MEMSセンサーのテスト技術 渡部 彰一（東京エレクトロン）
⑫16:40–17:00	総合討論 益 一哉（東工大）

問合せ先
社団法人 応用物理学会　事務局　岡本
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-12-3 井門九段北ビル5F
Tel:03-3238-1041　Fax:03-3221-6245　E-mail:soka@jsap.or.jp

応用物理学会